

# 龍華科技大學資訊管理系學生企業實習

## 112 學年度 企業合作意願書

媒合日期：112 年 4 月 27 日(四)13:00

企業名稱	日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司	營利事業統一編號	70848839
聯絡人姓名	劉宴廷/Amber	聯絡電話	0937633352
E-mail	Amber_liu@aseglobal.com		
聯絡地址	桃園市中壢區中華路一段 550 號		
實習期間	自 112 年 7 月 1 日起至 113 年 6 月 30 日止		

### 應試方式

☐採現場面試(媒合)。出席人數： 1 人。車號： ALA-3239

■採書面申請。聯絡方式:投寄履歷到 Amber\_liu@aseglobal.com

### 實習類別

☐上學期(112.09.01~113.01.31)

☐下學期(113.02.01~113.06.30)

■一學年

### 職稱與專長需求 ( 可自行增列 )

1.僅支領部分津貼(交通、伙食等)，未達基本工資者均視為無薪。

2.若同一職稱同時有支薪與無薪職務，請分兩項列出。

職務名稱	有/無薪(勾選)	人數	專長需求	工作內容
(儲備) 助理工程師	<p>●有薪: 30450-55565 (含加班)</p> <p>○無薪: _____</p>	10	理工/資訊類相關背景	<p>1.半導體機台操作/基本改機</p> <p>2.設備機台維護保養/異常排除</p> <p>3.工作內容需長時間久站/接觸化學藥品(酒精、丙酮)/英文介面機台/需穿無塵服</p>
備 註	<p>1.有薪者請在此註明支薪方式 (按時/日/週/月支付) 與金額。</p> <p>2.無薪者如有其他津貼，亦需於此註記。</p> <p>3.實習期間保險：意外身故殘廢保險 100 萬元，實支實付型傷害醫療保險 10 萬元。</p>			